Objekttyp: **Miscellaneous**

Zeitschrift: **Schweizer Ingenieur und Architekt**

Band (Jahr): **106 (1988)**

Heft 12

PDF erstellt am: **28.03.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

Aus Technik und Wirtschaft

IBM SNA/SDLC im Ethernet Wide Area Network

Die Firma Teleinform AG, Bubikon bietet mit TransSDLC eine Erweiterung der 802 WAN TM Familie von Vitalink an.

TransSDLC integriert IBM FEP und Cluster Controller in bestehende Netzwerke wie z. B. Ethernet und benützt diese Netzwerke als Übermittlungsmedium. Daten können am gleichen oder einem remote LAN via TransLAN-Bridge ausgekoppelt werden. TransSDLC übermittelt kein Polling. IDLE-Pakete werden ebenfalls unterdrückt. Dieses Gerät ersetzt keine FEP oder Cluster Controller sondern integriert diese in bestehende Netzwerke. Bei Netzwerkänderungen muss nur das TransSDLC neu konfiguriert werden. Mit TransSDLC können FEP-Ports eingespart werden.Eine 56 Kbps FEP – TransSDLC Verbindung kann z. B. für 5 Cluster Controller konfiguriert werden. Auf der Remote-Seite können die 5 Cluster Controller mit verschiedenen Geschwindigkeiten, point to point oder multipoint angeschlossen werden.

Die meisten Parameter in TransSDLC werden On-line konfiguriert um Betriebsunterbrüche klein zu halten. TransSDLC hat eine Konfigurationstabelle für maximal 32 SDLC PU2 und unterstützt Kanalgeschwindigkeiten bis zu 64 Kbps mit RS 232/V.35 Schnittstellen.

Umfassende Statistiken über Verzögerungszeiten, Laufzeiten der Pakete, Linkauslastung, etc. können an der Konsole abgerufen werden.

TransSDLC arbeitet als «Host Interface Processor» (HIP) oder «Cluster Interface Processor» (CIP). Die SNA FEP/Host erkennen einen HIP als eine oder mehrere sekundäre SDLC Station SNA 3270 Cluster. Ein HIP beantwortet Host-Polling und Daten sofort und garantiert die Datenübermittlung. Ein HIP deaktiviert idle HIP zu CIP Verbindungen ohne LU – LU Verbindungen zu unterbrechen.

SDLC Cluster Controller erkennen einen CIP als einen IBM SNA 3725 FEP. Ein CIP emuliert das FEP Polling lokal und beantwortet Daten sofort. PU4 zu PU2 Verbindungen.

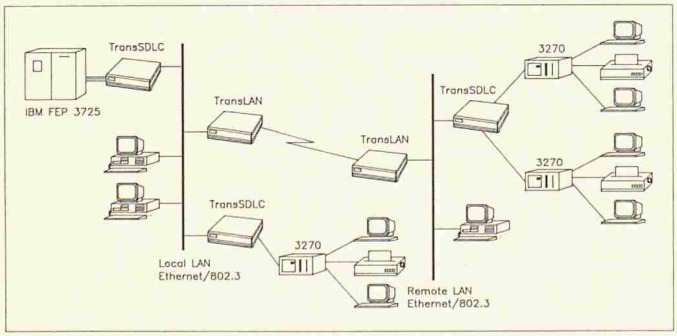
Bei einer TransSDLC Installation erübrigt sich meistens eine SYSGEN-Änderung der SNA FEP/Host Software und Hardware.

Typische Anwendung: Anstelle von Parallel-Führung von IBM und Ethernet Verkabelungen, Einsatz des TransSDLC zur gleichzeitigen Übermittlung von IBM Daten über das 10 Mbps Ethernet-Kabel.

TransSDLC besitzt die gleiche Software Management wie TransLAN, TransLINK und TransRING.

Teleinform AG
8608 Bubikon

TransSDLC Konfiguration



Neues «Kleb- und Dichtungswunder»

Auf jeder Baustelle gibt es immer etwas abzudichten, anzukleben oder zu reparieren! Speziell für diese Art von Arbeiten wurde die elastische, preisgünstige und praktisch universell einsetzbare Kleb- und Dichtungsmasse Tegucol 310 entwikkelt. Tegucol 310 ist eine Masse auf der Basis von modifiziertem Spezialbitumen und ist prädestiniert für folgende Einsatzbereiche: Als *Haftmittel* für bituminöse Dachdeckungen, als *Dichtungsmasse* für Risse und Fugen, zum *Kaltverkleben* der Stösse bei Bitumenunterdächern (z.B. Tegubit), als *Reparaturmasse* bei undichten Rinnen, als *Abdichtungsmasse* bei Kamin- und Fensterabschlüssen usw.

Tegucol 310 haftet hervorragend auf Beton, Stein, Asbestzement, Pappe, Glas, Tegubit, Holz etc. Sogar auf feuchten Untergründen ist eine hohe Kleb- und Haftkraft gewährleistet. Tegucol 310 ist in Kartuschen à 310 ml erhältlich, und das Produkt wird mittels einer handelsüblichen Kittpistole verarbeitet.

Tegucol 310 wurde von Fachleuten für Fachleute entwickelt und gehört auf jede Baustelle!

Tegum AG
Leutschenbachstr. 45
8052 Zürich

Neu von Sigma Coatings

Sigma Coatings ist die erste Firma auf dem Markt mit Pulverbeschichtungen auf Kynar PVDF-Basis für dauerhaftere Aussenflächen von Bauwerken
Das holländische Unternehmen Sigma Coatings B. V., Hersteller von Schutzbeschichtungen für Bauwerke, hat ein neues Pulverbeschichtungssystem für Aluminiumprofile und Verkleidungen entwickelt. Es basiert auf dem bereits durch seine hohe Beständigkeit bei der Beschichtung von Bauten bekannten Kynar PVDF (Polyvinylidenfluorid) von Pennwalt. Diese Lacke auf Fluorid-Polymer-Basis wurden bisher als Nasspray aufgetragen. Sigma hat es jetzt möglich gemacht, PVDF als Pulverbeschichtung aufzutragen und bringt es als erste Firma in den Handel.
Das System wurde auf Anregungen von Architekten und verarbeitenden Betrieben entwickelt. Verarbeitende Betriebe fordern ein wirksameres, emissionsfreies Verfahren für PVDF-Spraybeschichtung. Und Architekten und Designer verlangen ein besseres Qualitätsprodukt als Polyester-Pulverbeschichtungssysteme. Sigma hat für beide Probleme eine Lösung – PVDF-Pulver.

Das neue Pulverbeschichtungssystem auf PVDF-Basis hat alle Vorteile eines Hochleistungs-PVDF-Nassspraysystems, jedoch mit verbesserten mechanischen Eigenschaften: ein einmaliger Auftrag sorgt für eine dikkere Schutzschicht. Verglichen mit Polyester-Pulver bedeutet es: ausgzeichnete Witterungs- und Korrosionsbeständigkeit, chemische Beständigkeit und geringe Wartung. Die neue Pulverbeschichtung auf PVDF-Basis ist hinsichtlich Flexibilität, Kratz- und Schlagbeständigkeit besser als Nass-Systeme. Eine Lage PVDF-Pulver von Sigma ist dikker als zwei oder drei Lagen PVDF-Nasspray. Ein Bauwerk wird gleichermassen mit einem Hochleistungs-Kunststoff-Schutzfilm versehen.

Auf Lack- und Glanzbeständigkeit, Lichtechtheit, Kreiden, Adhäsion und Korrosion wird 10 Jahre Garantie geleistet, wenn die Pulverbeschichtung auf PVDF-Basis von einem von Sigma autorisierten Verarbeitungsbetrieb nach den Sigma-Qualitätsnormen aufgetragen wird.

Sigma Coatings BV
NL-3700 AC Zeist

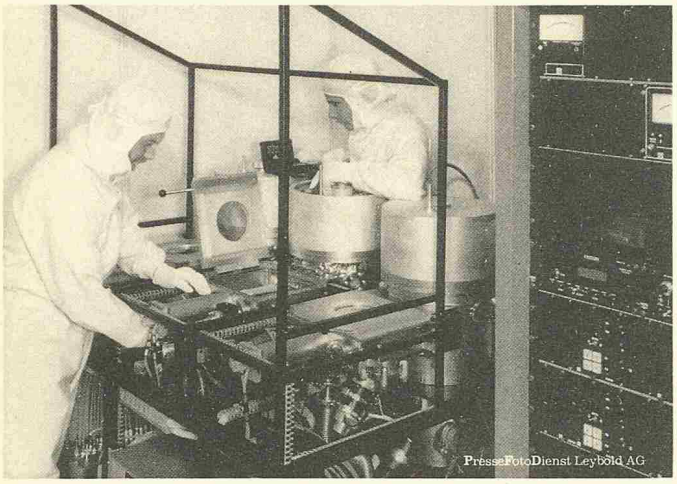
Neue Broschüre: Die Industrieverkabelung

Viele nützliche Tips und Anregungen für die Praxis: Heutzutage werden immer mehr Kommunikations- und Energiekabel in Industriebetrieben, Grosskraftwerken und ähnlichen Objekten zusätzlich oder neu verlegt. Marktuntersuchungen haben gezeigt, dass diese Verkabelungen sehr personal- und damit kostenintensiv sind.

Zeitgemässe Methoden der Industrieverkabelung finden deshalb immer grössere Bedeutung. Rationelle Arbeitstechniken erleichtern nicht nur die Verlegung, sondern machen diese vor allem kostengünstiger.
Lancier-Know-how und nützliche Anregungen aus der Praxis waren Anlass für die Herausgabe der Broschüre «Die Industrieverkabelung» mit vielen Tips, praktischen Hinweisen und informativen Abbildungen. Interessenten erhalten diese Informationsbroschüre kostenlos.

Lancier
Maschinenbau-Hafenhütte
Postfach 47 01 60
D-4400 Münster-Wolbeck

Miniaturisierung im Submikronbereich



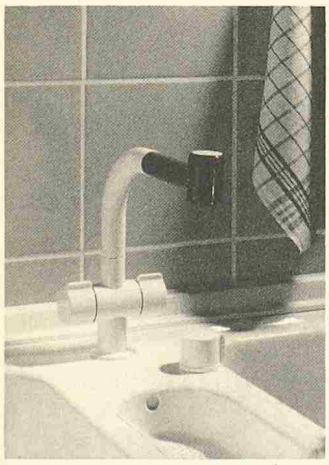
Miniaturisierung ist das Schlagwort und der Trend in der Mikroelektronik. Die Strukturen auf den Waferscheiben – aus denen später die Chips hergestellt werden – haben inzwischen Grössenordnungen des Submikronbereiches erreicht. D. h. sie sind kleiner als eintausendstel und bis zu einhunderttausendstel Millimeter klein. Zum Herstellen solcher Strukturen werden chemische Ätzprozesse unter Vakuum eingesetzt. Die gezeigte Dreikammer-Wafer-Plasma-Ätzanlage arbeitet mit TRIVAC BCS-Drehschieberpumpen und RUVAC-Wälzkolbenpumpen der Leybold AG. Da beim Ätzen äusserst aggressive Gase benutzt werden, müssen die ölgedichteten Vakuumpumpen extremen Belastungen standhalten.

Leybold AG, Köln

SPRINT Küchenarmatur mit Auszugsbrause

Jetzt gibt es SPRINT, die erste Küchenarmatur im modernen High-Tech-Design mit Auszugsbrause.

Die SPRINT Küchenbatterie, welche bereits mit mehreren Designpreisen ausgezeichnet wurde und zweifellos ein Blickfang in jeder Küche ist, verfügt über eine praktische Auszugsbrause mit verstellbarem Wasserstrahl (Soft- und Regenstrahl), der jedem Anspruch gerecht wird.



Im technischen Bereich lässt die SPRINT Armatur (S 1040) ebenfalls keine Wünsche offen. Dank der modernen Keramikscheibentechnik lässt sich mit einer Griffdrehung von 180° sowohl Wassermenge wie Temperatur aufs feinste regulieren; auch das lästige Tropfen wegen abgenützten Gummidichtungen ist bei der SPRINT Küchenbatterie nicht mehr möglich.

Die SPRINT Armaturen sind in allen gängigen Sanitärfarben beim Sanitär-Installateur oder beim Sanitär-Grosshandel erhältlich.

Metallgiesserei & Armaturenfabrik Lyss
Zeughausstrasse 17, 3250 Lyss
Tel. 032/84 34 64

Tagungen

«Forschung im Dienste der Praxis»

Stahlbautag zu Ehren Professors John W. Fisher

Professor Dr. *John W. Fisher*, der an der Universität Lehigh, Bethlehem, USA, Bauingenieurwissenschaften lehrt, wird am 3. Mai 1988 die Würde eines Ehrendoktors der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne verliehen.

Prof. Fisher zu Ehren veranstaltet das ICOM-Construction métallique der ETH-Lausanne am *Mittwoch, den 4. Mai 1988* einen Stahlbautag unter dem Motto: «Forschung im Dienste der Praxis».

Vorträge werden halten die HH. Professoren J. Brozzetti (ENPC, Paris), A. W. *Pense* (Lehigh), *J. W. Fisher* (Lehigh), sowie fünf Redner aus dem Kreise der ETH-L.

Auskünfte, Programme und Anmeldungen: Sekretariat ICOM-Construction métallique, EPFL, GC-Ecublens, 1015 Lausanne. Tel. 021/47 24 22. Anmeldefrist bis am 15. April 88.

High Tech in Österreich

Das 3. Kolloquium der IHB-Stiftung (International High-Tech-Forum Basel) findet am 28./29. April 1988 in Wien statt. Tagungsort ist das Technische Zentrum Creditanstalt-Bankverein, Julius Tandler-Platz, 1090 Wien. An der Organisation mitbeteiligt sind das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung, das Österreichische Forschungszentrum Seibersdorf, die Vereinigung Österreichischer Industrieller, die technova Graz. Das Tagungsthema «High Tech in Österreich» wird an Entwicklungsbeispielen aus den Regionen Wien und Graz abgehandelt, wobei die in den Referaten vermittelten Hintergrundinformationen durch Diskussionen und Besichtigungen von Firmen und Forschungsinstituten vertieft werden. Das Detailprogramm ist über folgende Kontaktadresse erhältlich: International High-Tech-Forum Basel, Frau R. Bruns-Marty, c/o Schweizer Mustermesse, Postfach, 4021 Basel.

Weiterbildung

Wissenschaft und Praxis: Bauseminar

Oberflächenschutz von Stahlbeton

mit flexiblen Dichtungsschlämmen im konstruktiven Ingenieurbau

Ein Weiterbildungsseminar der Bauakademie Biberach/D, in Lindau am 15. April 1988.

Seminarleitung: Prof. Dipl.-Ing. *CH. Roller*, Rektor der Fachhochschule Biberach, Prof. Dr. *R. Springenschmid*, TU München

Teilnehmergebühr DM 194.–

Anfragen, Anmeldungen: Bauakademie Biberach, Postfach 1260, D-7950 Biberach (Riss) 1, Tel. (0 73 51) 5 82-18.

Bauherr und Haustechnik

Veranstaltung im Rahmen des Impulsprogramms Haustechnik in Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Hauseigentümerverband

Zürich, 4. Mai 1988, im ETH-Zentrum

Teilnehmerkreis: Die Veranstaltung richtet sich vor allem an Bauherren, die wiederholt Dienstleistungen der Haustechnikbranchen (Heizung, Lüftung, Klima, Sanitär, Elektro) für Neubauten, Sanierungen oder den Betrieb ihrer Liegenschaften in Anspruch nehmen. Auch Architekten in ihrer Funktion als Bauherrenvertreter und Koordinatoren des Planungs- und Bauablaufs sind angesprochen.

Inhalt: Die Qualität einer haustechnischen Anlage äussert sich nicht nur in der Höhe der Investitionen und im gelieferten Komfort, sondern auch in der Zuverlässigkeit und den Betriebskosten. Die Veranstaltung will dem Teilnehmer zeigen, welche Hindernisse sich dieser Qualität von der Idee bis zum Betrieb entgegenstellen und wie er bei der Auswahl seiner Fachleute, beim Formulieren der Ziele und Randbedingungen, im Werkvertrag, bei der Abnahme und während des Betriebs diese Hindernisse aus dem Weg räumen kann.

Weitere Auskünfte und Anmeldeunterlagen: Koordination der Fachverbände IPHT, Postfach 65, 8117 Fällanden, Tel. 01/825 08 12 (R. Aeberli).